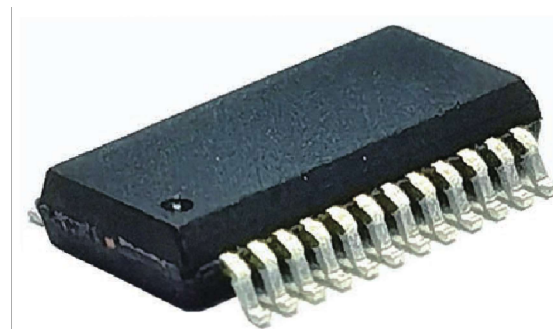




SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.75
A1	0.10	0.15	0.20
A2	1.35	1.45	1.55
b	0.23	-	0.31
b1	0.22	0.25	0.28
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	8.56	8.66	8.76
Df	8.66	-	9.16
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	0.635 BSC		
L	0.51	0.66	0.81
L1	0.95	1.05	1.15
θ	0	-	8°
f	0.05	-	0.20

Note:

1. All dimension are in mm.
2. Dim D & E1 does not include plastic flash;
Df includes plastic flash(f);
Flash: Plastic residual around body edge after
dejunk/singulation.
3. Dim b does not include dambar protrusion/intrusion.
4. Plating thickness 0.007mm-0.015mm



拟制		复审	
审核		会签	
		标准化	
制图		批准	
幅面: A4		比例: 1:1	

更改标记	更改内容	签 名	日 期
<div><div>永嘉微电 Vinka Microelectronics</div></div>			
VKXHSSOP24V11_POD 产品外形图名称		图 号: VKXHSSOP24V11_POD	
		单 位	版 本
		mm	V1.1
		第 1 张	共 1 张
<div></div>			